

平成20年11月14日

各 位

会 社 名 株式会社 アバールデータ
 代 表 者 名 代表取締役社長 嶋 村 清
 (JASDAQ コード番号 6918)
 問 い 合 わ せ 先 管理本部 部長 大関 拓夫
 T E L 042-732-1000

平成21年3月期業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ

平成20年9月19日付「平成21年3月期業績予想（連結・個別）及び配当予想の修正に関するお知らせ」及び平成20年10月1日付「特別損失の計上及び平成21年3月期第2四半期累計期間業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」にて発表いたしました平成21年3月期（平成20年4月1日～平成21年3月31日）に関する前回の業績予想を下記のとおり修正いたします。

記

I. 平成21年3月期第2四半期累計期間・通期業績予想（連結・個別）の修正について

1. 平成21年3月期第2四半期累計期間・通期業績予想（連結・個別）の修正

〔 連結業績予想 〕

平成21年3月期第2四半期連結累計期間業績予想の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日）

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり当期 純利益 (円銭)
前回発表予想 (A) (平成20年10月1日発表)	3, 110	76	130	24	3.07
今回修正予想 (B)	3, 099	38	93	24	3.07
増減額 (B-A)	△11	△38	△37	0	—
増 減 率	△0.4%	△50.0%	△28.5%	0.0%	—
前 期 実 績 (平成19年9月中間期)	4, 554	603	631	361	46.29

平成21年3月期通期連結業績予想の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり当期 純利益 (円銭)
前回発表予想 (A) (平成20年9月19日発表)	6, 500	316	406	255	32.62
今回修正予想 (B)	5, 800	95	190	50	6.40
増減額 (B-A)	△700	△221	△216	△205	—
増 減 率	△10.8%	△69.9%	△53.2%	△80.4%	—
前 期 実 績 (平成20年3月期)	8, 465	929	989	582	74.59

[個別業績予想]

平成21年3月期第2四半期累計期間業績予想の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日）

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり当期 純利益 (円銭)
前回発表予想 (A) (平成20年10月1日発表)	2,050	80	172	65	8.32
今回修正予想 (B)	2,051	74	166	78	9.99
増減額 (B-A)	1	△6	△6	13	—
増減率	0.0%	△7.5%	△3.5%	20.0%	—
前期実績 (平成19年9月中間期)	3,109	434	523	348	44.62

平成21年3月期通期業績予想の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	経常利益 (百万円)	当期純利益 (百万円)	1株当たり当期 純利益 (円銭)
前回発表予想 (A) (平成20年9月19日発表)	4,280	240	367	261	33.39
今回修正予想 (B)	3,680	74	206	86	11.01
増減額 (B-A)	△600	△166	△161	△175	—
増減率	△14.0%	△69.2%	△43.9%	△67.0%	—
前期実績 (平成20年3月期)	5,548	643	763	517	66.26

2. 業績予想の修正理由

[連結業績予想]

当社グループに関連の深い半導体製造装置業界は、昨年末より急激な減速傾向を示しており、今年度の業績の予想にあたり大幅な減少を予測しておりました。しかしながら半導体メーカーの設備投資の抑制が継続するなど半導体製造装置市場の低迷は当初の予想以上に長期化しております。

第2四半期累計期間の業績につきましては、平成20年10月1日付「特別損失の計上及び平成21年3月期第2四半期累計期間業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」にて業績予想の修正を行いましたが、営業利益においては、受託製品・半導体製造装置関連の需要の減少及びそれに伴う生産稼働率の低下並びに利益率の高い自社製品の売上減少により、更に予想を下回る見込みであり、またこれに伴い経常利益におきましても上記のとおり修正いたします。

また通期業績につきましては、平成20年9月19日付「平成21年3月期業績予想（連結・個別）及び配当予想の修正に関するお知らせ」にて業績予想の修正を行いましたが、第2四半期までの業績等を踏まえ10月以降においても、受託製品・半導体製造装置関連の需要の減退が続くことが想定されるため、再度業績予想を見直した結果、上記のとおり修正いたします。

[個別業績予想]

個別業績につきましても当社を取り巻く環境はほぼ上記連結業績における状況のとおりであります。第2四半期累計期間の業績につきましては、平成20年10月1日付「特別損失の計上及び平成21年3月期第2四半期累計期間業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」にて業績予想の修正を行い概ね予定どおりに推移いたしました。

また通期業績につきましては、平成20年9月19日付「平成21年3月期業績予想（連結・個別）及び配当予想の修正に関するお知らせ」にて業績予想の修正を行いましたが、連結業績予想と同様、現状における業績予想の見直しを行った結果、上記のとおり修正いたします。

配当につきましては、平成20年9月19日の前回発表予想より変更はございません。

以 上

ご注意 : 上記の業績予想及び配当予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。

第50期 業績予想修正・連結(品目別)

平成21年3月期(2008年4月1日－2009年3月31日)

単位 百万円

品目	項目	第2四半期累計期間				通 期			
		08/10/1 発表値	08/11/14 発表値	増減率	前年同期 実績	08/9/19 発表値	08/11/14 発表値	増減率	前年同期 実績
自社製品	組込みモジュール	310	310	0.0%	581	670	605	-9.7%	995
	画像処理モジュール	301	302	0.3%	273	631	623	-1.3%	559
	計測通信機器	316	328	3.8%	535	756	701	-7.3%	1,144
受託製品	半導体製造装置関連	1,075	1,065	-0.9%	2,166	2,245	1,854	-17.4%	3,654
	産業用制御装置	565	546	-3.4%	459	1,080	1,002	-7.2%	892
	計測機器	395	399	1.0%	488	840	802	-4.5%	976
商品(自社製品関連)		148	148	0.0%	53	278	213	-23.4%	245
売上合計		3,110	3,099	-0.4%	4,554	6,500	5,800	-10.8%	8,465
営業利益		76	38	-50.0%	603	316	95	-69.9%	929
経常利益		130	93	-28.5%	631	406	190	-53.2%	989
当期純利益		24	24	0.0%	361	255	50	-80.4%	582